

©1995 г.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ  
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА  $\text{SiO}_2\text{-SiC}$  ПУТЕМ АНАЛИЗА  
ВХОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВОДИМОСТИ  
МОП СТРУКТУРЫ  
В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ**

*П.А.Иванов, В.Н.Пантелеев, Т.П.Самсонова, В.Е.Челноков*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,  
194021, Санкт-Петербург, Россия

(Получена 30 июня 1994 г. Принята к печати 11 июля 1994 г.)

Для системы диэлектрик-(широкозонный полупроводник) модифицированы известные методики исследования поверхностных состояний с квазинепрерывным распределением по энергиям в запрещенной зоне полупроводника. В основу положен анализ характеристик МОП структуры типа емкость-напряжение и проводимость-напряжение, измеряемых на фиксированной частоте (1 кГц) в температурном интервале 296–580 К. Проведено исследование поверхностных состояний в системе  $\text{SiO}_2\text{--}(n\text{-}6H\text{-SiC})$  с ориентацией (0001) Si. Показано, что поверхностные состояния с энергиями в верхней половине запрещенной зоны 6H-SiC имеют низкое сечение захвата электронов ( $\simeq 10^{-17} \text{ см}^2$ ) и поэтому могут считаться акцептороподобными. Минимум плотности состояний ( $D_t^{\min} = 2 \cdot 10^{11} \text{ эВ}^{-1}\text{см}^{-2}$ ) приходится на энергию 0.4 эВ ниже дна зоны проводимости, однако плотность состояний возрастает в несколько раз при приближении как к дну зоны проводимости, так и к середине запрещенной зоны.

### Введение

Хорошо известно, что характеристики приборов со структурой метал-диэлектрик-полупроводник во многом контролируются поверхностными состояниями (ПС) на границе диэлектрик-полупроводник. В исследованиях электронных состояний на поверхности раздела кремний-(термический окисел) широкое распространение получили методы исследования МОП структур, основанные на анализе их входной комплексной проводимости (входного адmittанса). В частности, в методе Термана [1] анализируется зависимость входной емкости, измеряемой на фиксированной высокой частоте, от поверхностного потенциала. Данный метод позволяет определить только распределение

плотности ПС по энергиям в запрещенной зоне полупроводника. В методе Николлиана и Гоетцбергера [2] анализируется зависимость активной составляющей входного адmittанса, измеряемой при фиксированной величине поверхностного потенциала, от частоты. В данном случае возможно определение как энергетического распределения плотности ПС, так и сечения захвата на них основных носителей. Важно отметить, что оба метода применимы при условии квазиравновесного заполнения поверхностных ловушек по отношению к медленным изменениям поверхностного потенциала. В частности, время перезарядки поверхностных состояний на интерфейсе  $\text{SiO}_2\text{-Si}$  не превышает при комнатной температуре нескольких единиц секунд. Поэтому в случае кремния достаточно использовать указанные выше методики исследования только при комнатной температуре. Определение параметров электронных состояний на границе раздела диэлектрика с более широкозонными полупроводниками (в частности, с SiC) требует измерений при повышенных температурах. При этом сами методы анализа могут быть несколько модифицированы.

### Методика исследования

Анализ входного адmittанса МОП структуры, если он измерен на фиксированной частоте в некотором диапазоне температур, может быть осуществлен следующим образом. Рассмотрим простейшую эквивалентную схему МОП структуры, учитывающую наличие поверхностных состояний (рис. 1). На показанной схеме  $C_{ox}$  — емкость окисла,  $C_s$  — емкость области пространственного заряда полупроводника,  $C_t$  и  $G_t$  — зависящие от частоты емкостная и активная компоненты адmittанса поверхностных состояний. Величины  $C_t + C_s$  и  $G_t$  легко определяются в соответствии с данной эквивалентной схемой, если измерены компоненты входного адmittанса МОП структуры ( $C$  и  $G$ ) и емкость окисла ( $C_{ox}$ ):

$$C_s + C_t = \frac{C_{ox}C}{C_{ox} - C} - \frac{(G_t/\omega)^2}{C_{ox}},$$

$$G_t = \frac{G}{(1 - C/C_{ox})^2}.$$

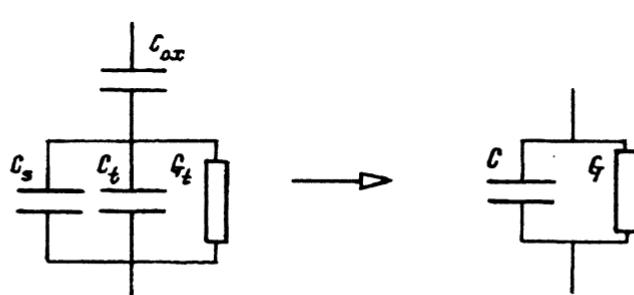


Рис. 1. Эквивалентная схема МОП структуры, учитывающая наличие поверхностных состояний, и параллельная схема ее замещения.

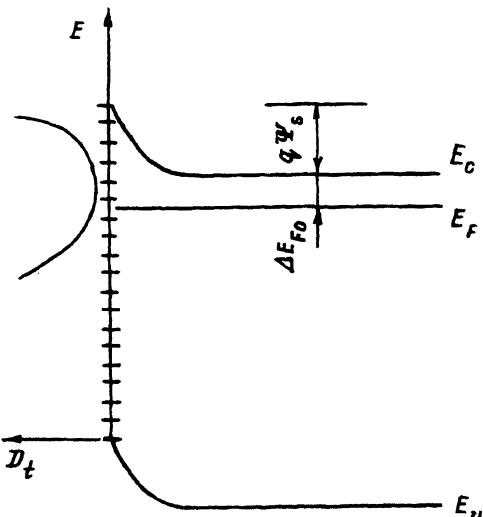


Рис. 2. Энергетическая диаграмма приповерхностной области полупроводника n-типа проводимости с кванзинепрерывным распределением поверхностных состояний по энергиям в запрещенной зоне.

Рассмотрим далее модель кванзинепрерывного распределения поверхностных состояний по энергиям (рис. 2). Согласно этой модели, активная и реактивная компоненты адmittанса ПС связаны с их энергетической плотностью  $D_t$  и сечением захвата  $\sigma_t$  следующими соотношениями [6]:

$$C_t = q D_t S (\operatorname{arctg} \Omega) / \Omega,$$

$$\frac{G_t}{\omega} = q D_t S \frac{\ln(1 + \Omega^2)}{2\Omega},$$

$$\Omega = \omega / \sigma_t v n_s,$$

где  $\omega$  — круговая частота измерительного сигнала,  $n_s$  — поверхностная концентрация электронов в полупроводнике. Последняя определяется равновесной концентрацией электронов в объеме полупроводника  $n_0$  и величиной поверхностного потенциала  $\Psi_s$ :

$$n_s = n_0 \exp(q\Psi_s/kT).$$

Безразмерная частота  $\Omega$ , как видно из приведенных формул, зависит от  $\Psi_s$ , т.е. от напряжения  $V$ , приложенного к затвору МОП структуры. Проводимость ПС, нормированная на частоту  $(G_t/\omega)$ , проходит через максимум при некотором напряжении  $V$ , соответствующем условию  $\Omega = 1.98$ , т.е. при  $\omega t = 1$ , где  $t = 1.98 (\sigma v n_s)^{-1}$  — время релаксации ПС. Это сразу позволяет определить энергетическую плотность данных ПС  $D_t$  из формулы  $(G_t/\omega)_{\max} = 0.4qD_t$ . Далее можно вычислить емкость ПС по формуле  $(C_t)_{\max} = 1.37(G_t/\omega)_{\max}$  и емкость  $C_s$ , соответствующую напряжению  $V_{\max}$ . Определив поверхностную емкость полупроводника, становится возможным рассчитать величину поверхностного потенциала  $\Psi_s$  и сечение захвата основных носителей  $\sigma_t$  (по теории поверхностной емкости широкозонного полупроводника с глубокой легирующей примесью, см. [3]).

Поскольку получаемые таким образом параметры  $D_t$  и  $\sigma_t$  относятся к тем ПС, энергия ионизации которых  $\Delta E_t = \Delta E_{F_s}$  ( $\Delta E_{F_s}$  — положение уровня Ферми на границе раздела при заданном  $\Psi_s$ ), от величины

$D_t(\Psi_s)$  можно перейти к  $D_t(\Delta E_t)$ . Для этого необходимо рассчитанному значению  $\Psi_s$  сопоставить энергию

$$\Delta E_t = q|\Psi_s| + \Delta E_{F0},$$

где  $\Delta E_{F0}$  — положение уровня Ферми в объеме полупроводника. Для монополярного полупроводника  $n$ -типа величина  $\Delta E_{F0}$  является решением уравнения электронейтральности

$$n_0 = N_c \exp(\Delta E_{F0}/kT) = \frac{N_d}{1 + 2 \exp\left(\frac{\Delta E_d - \Delta E_{F0}}{kT}\right)},$$

где  $N_c$  — эффективная плотность состояний в зоне проводимости,  $N_d$  — концентрация доноров,  $\Delta E_d$  — энергия ионизации доноров. С ростом температуры соотношение  $\omega\tau = 1$  будет выполняться для всех более глубоких ПС. Таким образом, проводя рассмотренные экспериментальные и расчетные процедуры при разных температурах в некотором интервале, можно определить энергетическое распределение плотности ПС и зависимость сечения захвата на них основных носителей от энергии.

### Экспериментальные образцы

Для измерений были использованы МОП структуры Al-SiO<sub>2</sub>-( $n$ -6H-SiC), исследованные ранее при комнатной температуре методом Термана [4]. Пленки 6H-SiC  $n$ -типа были выращены методом вакуумной сублимационной эпитаксии на грани (0001)Si монокристаллических пластин  $n$ -типа с удельным сопротивлением  $\approx 1$  Ом · см. Для окисления были отобраны пленки с концентрацией нескомпенсированных доноров  $3 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>. Окисление проводилось при температуре 1100 °С в течение 5 ч. При этом в поток сухого кислорода (расход 500 см<sup>3</sup>/мин) вводились пары C<sub>2</sub>HС<sub>3</sub> так, как это делается при «хлорном» окислении кремния с целью уменьшения концентрации подвижных ионов и фиксированного заряда в окисле, а также плотности ПС. Для формирования полевого электрода на окисленную поверхность SiC напылялся слой алюминия; контактные площадки размером  $0.175 \times 0.225$  мм<sup>2</sup> изготавливались фотолитографией. Омическим контактом к подложке служил никель, нанесенный ионным распылением. После изготовления МОП структуры отжигались в аргоне (с целью стабилизации свойств) при температуре 450 °С в течение 1 ч.

### Экспериментальные результаты

Как было показано выше, для определения энергетического распределения плотности ПС и сечения захвата на них основных носителей достаточно в некотором интервале температур измерить на фиксированной частоте вольт-фарадные ( $C-V$ ) характеристики и характеристики типа проводимость-напряжение ( $G-V$ ). В настоящем исследовании с этой целью  $C-V$  и  $G-V$ -характеристики измерялись на частоте 1 кГц, в диапазоне температур 296–580 К. Необходимая для анализа емкость окисла измерялась в режиме аккумуляции основных носителей у поверхности полупроводника, когда  $C_s \rightarrow \infty$ , а  $C = C_{ox}$ .

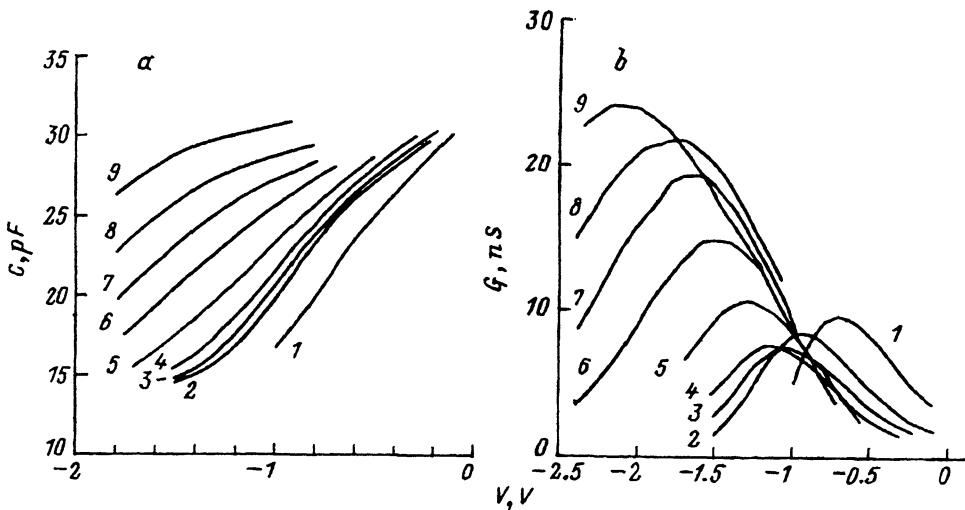


Рис. 3. Характеристики типа  $C-V$  (a) и  $G-V$  (b) МОП структуры  $\text{Al}-\text{SiO}_2-(n-6H-\text{SiC})$  на подложке (0001) Si, измеренные на частоте 1 кГц при температуре  $T$ , К: 1 — 296, 2 — 341, 3 — 368, 4 — 421, 5 — 445, 6 — 477, 7 — 510, 8 — 537, 9 — 580.

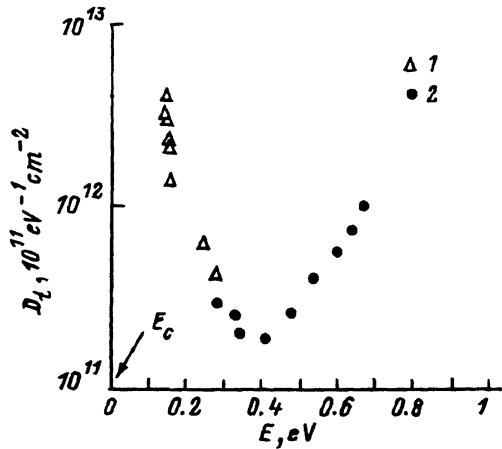


Рис. 4. Распределение плотности поверхностных состояний по энергиям в запрещенной зоне 6H-SiC. 1 — данные, полученные методом Термана при комнатной температуре [4]; 2 — данные, полученные в настоящем исследовании.

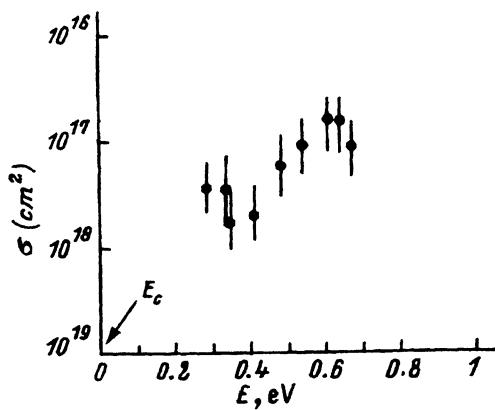


Рис. 5. Зависимость сечения захвата электронов в поверхностными состояниями от энергетического положения поверхностных состояний в запрещенной зоне 6H-SiC.

При напряжениях, соответствующих обеднению приповерхностной области полупроводника основными носителями,  $C-V$ - и  $G-V$ -характеристики имеют вид, показанный на рис. 3. Качественно эти зависимости соответствуют модели квазинепрерывного распределения ПС по энергиям. В частности,  $G-V$ -характеристики имеют вид кривых с максимумом, который смещается при увеличении температуры в сторону более отрицательных напряжений на затворе. Такое поведение свидетельствует о том, что для всех более глубоких состояний выполняется соотношение  $\omega\tau = 1$ .

Анализ экспериментальных зависимостей по описанной выше методике дал следующие результаты. Плотность поверхностных электронных состояний с энергиями в верхней половине запрещенной зоны  $6H$ -SiC изменяется немонотонно в зависимости от их энергетического положения. Минимум плотности состояний ( $D_t^{\min} = 2 \cdot 10^{11} \text{ эВ}^{-1} \text{ см}^{-2}$ ) приходится на энергию 0.4 эВ ниже дна зоны проводимости (рис. 4). Однако плотность состояний возрастает на порядок величины при приближении как к середине запрещенной зоны, так и к дну зоны проводимости (на рис. 4 приведены, помимо данных настоящего исследования, результаты работы [4], в которой методом Термана определено энергетическое распределение плотности ПС вблизи дна зоны проводимости). Важно отметить, что несмотря на то, что верхний предел измерений по температуре составлял 580 К, нам удалось зафиксировать лишь те поверхностные состояния, энергия ионизации которых не превышает 0.7 эВ. Причина состоит в том, что данные ловушки имеют низкое сечение захвата электронов, порядка  $10^{-17} \text{ см}^2$  (рис. 5). По-видимому, они могут считаться акцептороподобными, т.е. отрицательно заряженными в заполненном состоянии.

Работа выполнена при частичной поддержке Министерства обороны США.

#### Список литературы

- [1] L.N. Termaan. Sol. St. Electron., **5**, 285 (1962).
- [2] E.N. Nicollian, A. Goetzberger. Bell. Syst. Techn. J., **46**, 1055 (1967).
- [3] Л.Б. Елфимов, П.А. Иванов. ФТП, **28**, 161 (1994).
- [4] П.А. Иванов, А.О. Константинов, В.Н. Пантелеев, Т.П. Самсонова, В.Е. Челноков. ФТП, **28**, 1112 (1994).
- [5] П.А. Иванов, В.Н. Пантелеев, Т.П. Самсонова, А.В. Суворов, В.Е. Челноков. ФТП, **27**, 1146 (1993).
- [6] В.Н. Овсянков. Электронные процессы в полупроводниках с областями пространственного заряда (Новосибирск, 1984).

Редактор Т.А. Полянская

# Investigation of surface states at the $\text{SiO}_2$ -SiC interface by mean of analysis of input admittance of MOS Structure in a wide temperature range

P.A. Ivanov, V.N. Panteleev, T.P. Samsonova, V.E. Chelnokov

A.F. Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg,  
Russia

For a system dielectric-wide band-gap semiconductor, the very well known techniques of analysis of interface traps with continuous energy distribution within the semiconductors band-gap have been modified. The developed technique is based on the capacitance-voltage and conductance-voltage measurements at fixed frequency in a wide temperature range. Interface traps at the  $\text{SiO}_2/n\text{-}6H\text{-SiC}$  (0001)Si interface have been investigated. The temperature range was from 296 K to 793 K and the frequency was 1 kHz. It has been shown that interface traps with energies in the upper half of 6H-SiC band-gap have low capture cross-section of electrons ( $\simeq 10^{-18} \text{ cm}^2$ ) and can therefore be considered as the acceptor ones. The minimum of the surface state density ( $D_{t\min} = 2 \cdot 10^{11} \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-2}$ ) is located at 0.45 eV below the conduction band, but it increases up to  $\simeq 10^{12} \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-2}$  towards both the mid-gap and the conduction band bottom.

---